

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号: 2026-001

投资者关系活动类别	<div><input checked="" type="checkbox"/>特定对象调研<input type="checkbox"/>分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/>媒体采访<input type="checkbox"/>业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/>新闻发布会<input type="checkbox"/>路演活动</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>现场参观<input type="checkbox"/>电话会议</div> <div><input type="checkbox"/>其他</div>
参与单位名称	广发证券 个人投资者
会议时间	2026 年 1 月 8 日
会议地点	线下
上市公司接待人员姓名	董事 副总经理 董秘 财务总监：彭雅丽 证券事务代表：陈玲
投资者关系活动主要内容介绍	<p>Q：Wi-Fi 8 有无最新进展？</p> <p>A：据行业公开信息，Wi-Fi 8 技术标准预计于 2027 年底确立、2028 年正式发布，近期行业内已开始讨论 Wi-Fi 8 的初步愿景,为未来万物智联进一步奠定基础。</p> <p>从目前的认知来看，Wi-Fi 8 相比 Wi-Fi 7 的核心提升不完全在峰值速率，而聚焦于高密度/长距离场景下的可靠性、覆盖与并发效率。</p> <p>根据以往惯例推演，业界通常会在 2028 年协议标准正式批准之前就采取行动，草案规范和早期 Wi-Fi 8 芯片和原型机已处于陆续研发和推出阶段。近日，部分头部 SoC 厂商纷纷在 2026 年 1 月举行的国际消费电子展</p>

（CES）上发布初期版本的 Wi-Fi 8 相关芯片和设备，为未来 2028 年协议的最终落地提前布局 and 准备。如联发科推出 Wi-Fi 8 芯片平台，可广泛应用于网关、终端设备等场景并赋能 AI 应用，为各类产品带来高可靠性的连接能力；博通则发布 Wi-Fi 8 接入点芯片，不仅可支撑工业环境中机器人、传感器的可靠连接，也能为消费级 Mesh 网络提供更流畅的漫游体验。

公司已前瞻性布局 Wi-Fi 8，于 2025 年正式启动 Wi-Fi 8 FEM 预研工作；计划 2026 年推出支持相关协议的样品，同步配合高通、博通、联发科等国际主流 SoC 公司开展生态协同，抢占行业发展先机。作为网通 Wi-Fi FEM 的重要参与者，公司依托现有技术积累与市场判断能力，正通过预研工作储备 Wi-Fi 8 核心技术，为后续巩固行业竞争优势奠定坚实基础。

Q：今天参观了公司的实验室，请问公司是否还有其他生产车间？

A：公司无自有生产车间，采用集成电路行业通行的 Fabless（无晶圆厂）经营模式开展业务。芯片设计领域通常存在 Fabless 和 IDM 两种经营模式，Fabless 公司指只负责芯片产业链的设计和 sales 环节，中间的生产环节为委外代工方式，有利于集中资源投入核心研发环节；还有一种是 IDM 公司，是指从芯片设计、生产至 sales 环节全程覆盖的公司，具有资金雄厚，自身产量需求大等特点。目前两种模式并存。

Q：公司 2025 年第三季度营收表现已经超过 2024 年全年，2025 年全年业绩增速情况怎么样？

A：2025 前三季度，公司实现营业收入 5.26 亿元，已

	<p>超过 2024 年 5.23 亿营收，为全年的业绩奠定良好基础；2025 年全年的财务数据目前正处于最后的核算阶段。随着 Wi-Fi 7 相关订单持续增长、以无人机为代表的泛 IoT 领域产品持续获得创新，公司营业收入有望实现稳健增长。具体全年业绩增速情况，将在后续进行公开披露，敬请关注公司的相关公告及定期报告。</p>
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	本次活动不涉及应当披露重大信息。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 1 月 8 日